
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－戰略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的中位數），經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、[編纂]及估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，[編纂]淨額將約為[編纂]港元。

我們擬將[編纂]淨額用作以下用途及概約金額載列如下：

- [編纂]淨額約[45.0]%或[編纂]港元將用於興建及升級我們鍍層材料及鍍層服務的新生產線。根據弗若斯特沙利文的資料，中國先進封裝市場規模預計將從2024年的人民幣698億元增長至2029年的人民幣1,705億元，年複合增長率為19.6%。有關詳情，請參閱本文件「行業概覽－中國電子封裝市場概覽－中國先進封裝市場規模」。為滿足下游客戶日益增長的需求並利用有利的行業趨勢，我們將提升生產線及產能。尤其是：
 - 約[25.0]%或[編纂]港元將用於提升鍍層服務能力和升級鍍層服務生產設備。於往績記錄期間，我們鍍層服務產生的收入持續增加，且我們預期該業務分部日後將進一步增長。我們相信通過提升客制化服務，我們能夠承接客戶更先進的研發訂單及潛在的大規模生產。我們計劃投資先進的晶圓級和芯片級封裝以及PCB製造設備，以提高產能並擴大服務能力。與此同時，我們將進一步招募熟練的生產員工，擴張專門的鍍層服務團隊。該等策略性舉措旨在支持業務快速增長，同時針對客戶的不同需求提供高質量的客制化解決方案。我們計劃於[編纂]後的當前年度剩餘期間及於未來三年分別投入[編纂]港元及[編纂]港元。請參閱本文件「業務－製造與生產－創智芯工廠」。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[10.0]%或[編纂]港元將用於擴大鍍層材料產能及建設新生產線。我們計劃擴大高純鍍層材料產品組合、實施自動化和智能製造系統，並投資先進的質量控制設備。該等舉措旨在提高生產效率、加強質量管理，以及滿足高端客戶不斷變化的需求。我們計劃於[編纂]後的當前年度剩餘期間及於未來三年分別投入[編纂]港元及[編纂]港元。
- 約[10.0]%或[編纂]港元將用於在泰國建立海外生產基地及購置生產設備。我們將根據客戶分佈，在海外建設新生產基地，以更好地支持下游供應鏈，提升對海外需求的響應能力，並建立更高效的全球銷售網絡。請參閱本文件「業務－戰略－擴大鍍層材料與鍍層服務產能」。
- 約[30.0]%或[編纂]港元將用於研發、技術開發、產品升級及產品組合擴展。我們擬擴展至高純濕製程鍍層材料市場，側重晶圓和玻璃基板製造工藝的應用。同時，我們力爭深化鍍層材料的市場滲透率，並擴大其下游應用範圍。

為達成上述目標，我們計劃：(i)於[編纂]後的當前年度剩餘期間及於未來三年投入[編纂]港元，通過升級我們生產基地的相關開發及檢測設備，提升現有研發中心的製程能力；(ii)於[編纂]後的當前年度剩餘期間及於未來五年投入[編纂]港元，通過針對性的人才招募和結構化培訓計劃的實施，擴充研發團隊並加強創新能力；及(iii)於[編纂]後的當前年度剩餘期間及於未來五年投入[編纂]港元（該金額將按年分配使用），採購必要的原材料和耗材，以支持正在進行的研發和中試生產活動。

- 約[15.0]%或[編纂]港元將用於我們未來的潛在策略擴展機遇。我們將主要尋求通過收購中國或其他地區的集成電路產業鏈內的企業來擴展現有業務，旨在加快發展產品線佈局能力。截至最後實際可行日期，我們尚未就[編纂]用途擬投資任何特定擴張目標，亦未確定任何有關目標。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[10.0]%或[編纂]港元將用作一般企業及營運資金用途。

倘[編纂]高於或低於估計[編纂]的中位數，或[編纂]獲行使，則上述[編纂]分配將按比例進行調整。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的上限），並假設[編纂]未獲行使，我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、[編纂]及估計開支後，[編纂]淨額將約為[編纂]港元。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限），並假設[編纂]未獲行使，我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、[編纂]及估計開支後，[編纂]淨額將約為[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用於上述用途。

倘[編纂]淨額未能即時用於上述用途，且在適用法律及法規允許的情況下，我們擬將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及/或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。倘上述[編纂]擬定用途發生任何變化，我們將刊發適當公告。